



Funkcja modułu klejowego to dozowanie kleju w systemie klejenia na

Moduły klejowe serii H300 są wyprodukowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. W części klejowej modułu nie ma żadnych elementów mechanicznych, co poprawia przepływ kleju. Uzyskaliśmy dzięki temu również samoczyszczenie części klejowej modułu. Szczególnie jest to istotne przy pracy z „trudnymi” klejami. Iglica modułu pokryta jest tytanem, co wydłuża jej żywotność.

Parametry techniczne:

- Lepkość kleju do 20 000 mPas
- Zasilanie oczyszczonym powietrzem
- Ciśnienie powietrza powinno wynosić od 4-6 bar
- Ciśnienie kleju maksymalnie 100 bar
- Temperatury pracy do 200° C



Typy modułów klejowych

Moduł H300:

Idealne rozwiązanie do standardowych aplikacji.

Nr Katalogowy	Opis
000021	Moduł H300



Moduł H340 LL:

Moduł został zaprojektowany do szybkich i powtarzalnych aplikacji kleju.

Moduł jest otwierany oraz zamykany za pomocą sprężonego powietrza.

Nr Katalogowy	Opis
101007	Moduł H340 AOAC



Moduł H3000 S LL:

Najmniejszy moduł produkowany przez UES, wymiary jego to 16x17x45mm.

Moduł ten zaprojektowany jest do precyzyjnej czystej aplikacji kleju.

Nr Katalogowy	Opis
102841	Moduł H3000 S LL



Moduł H300 SP:

Moduł do aplikacji rozpryskowych, pasuje do głowic firmy UES jak i innych producentów.

Nr Katalogowy	Opis
102219	Moduł H300 SP

